

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 トルク電流および研磨レートの変化に依存せず、上層が研磨され、下層が露出した研磨終点を検出することができる研磨方法が開示される。研磨方法は、研磨テーブルを回転させながら、研磨テーブル上の研磨パッドに研磨液を供給し、ワークピースを研磨パッドに対して押し付けることで、研磨液の存在下でワークピースを研磨し、研磨テーブルが一回転するたびに、ワークピースに光を照射し、ワーク
- 10 スからの反射光のスペクトルを生成し、反射光のスペクトルと界面スペクトルとの類似度を示す指標値を算定し、指標値が最大または最小となった研磨終点を決定する。界面スペクトルは、参照ワークピースの研磨中に第1膜が除去されて、その下にある第2膜が露出したときに生成された参照ワークピースからの反射光のスペクトルである。

15

図 6